

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 18 年 12 月 21 日 (2006.12.21)

【公開番号】特開 2005-150294 (P2005-150294A)
【公開日】平成 17 年 6 月 9 日 (2005.6.9)
【年通号数】公開・登録公報 2005-022
【出願番号】特願 2003-383785 (P2003-383785)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 0 1 D

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 11 月 6 日 (2006.11.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

チップ搭載部と、
前記チップ搭載部の周囲に配置された複数のワイヤ接続部と、
複数の電極を有し、かつ前記チップ搭載部上に搭載された半導体チップと、
前記半導体チップの複数の電極と前記複数のワイヤ接続部をそれぞれ電氣的に接続する
複数のワイヤと、
前記チップ搭載部、前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、および前記複数のワイヤ接
続部を封止する封止樹脂部とを有し、
前記複数のワイヤ接続部は、第 1 のワイヤ接合部を有し、
前記複数の電極は、第 1 の電極と第 2 の電極を有し、
前記複数のワイヤは、一端が前記第 1 の電極と電氣的に接続される第 1 のワイヤと、一
端が前記第 2 の電極と電氣的に接続される第 2 のワイヤを有し、
前記第 1 のワイヤの他端は、前記第 1 のワイヤ接合部と電氣的に接続され、
前記第 2 のワイヤの他端は、前記第 1 のワイヤ接合部と電氣的に接続され、
前記第 1 のワイヤの他端と前記第 2 のワイヤの他端は、平面的に重なっていることを特
徴とする半導体装置。

【請求項 2】

タブと、
前記タブの周囲に配置された複数のリードと、
複数の電極を有し、かつ前記タブ上に搭載された半導体チップと、
前記半導体チップの複数の電極と前記複数のリードをそれぞれ電氣的に接続する複数の
ワイヤと、
前記タブ、前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、および前記複数のリードの一部を封
止する封止樹脂部とを有し、
前記複数のリードは、第 1 のリード部を有し、
前記複数の電極は、第 1 の電極と第 2 の電極を有し、
前記複数のワイヤは、一端が前記第 1 の電極と電氣的に接続される第 1 のワイヤと、一
端が前記第 2 の電極と電氣的に接続される第 2 のワイヤを有し、
前記第 1 のワイヤの他端は、前記第 1 のリード部と電氣的に接続され、

前記第 2 のワイヤの他端は、前記第 1 のリード部と電氣的に接続され、

前記第 1 のワイヤの他端と前記第 2 のワイヤの他端は、平面的に重なっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

請求項 2 記載の半導体装置において、

前記複数のリードの表面は銀めっき層が形成され、前記複数のワイヤは金から成ることを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】

請求項 3 記載の半導体装置において、

前記第 1 のワイヤの他端と前記第 2 のワイヤの他端の間には、金ボールが設けられていることを特徴とする半導体装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置